



HG5065B

产 品 规 格 书

标准

-

成分(w.%)

Ag: 47-51 | 树脂: 16-22 | 溶剂: 30-40

技术性能

细度 (μm): ≤ 10

电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$): $< 3 \times 10^{-5}$

推荐固化温度 ($^{\circ}\text{C}$): 130-150

· 粘度 ($\text{Pa} \cdot \text{s}$): 10-50

· 附着力 (B): 5

· 推荐固化时间 (min): 10-30

可制造能力

银浆细度: $\leq 10\mu\text{m}$

粘度: 可根据客户需求调整

应用

用途: 适用于PET基材, 用于制作薄膜开关、键盘等柔性线路。

特点: 本产品具有良好的导电率、优异的附着力及硬度, 适配卷对卷自动印刷、半自动印刷等工艺。

储存条件

本产品应密封储存, 储存环境温度5-30 $^{\circ}\text{C}$, 置于干燥、阴凉、通风良好的环境中。